

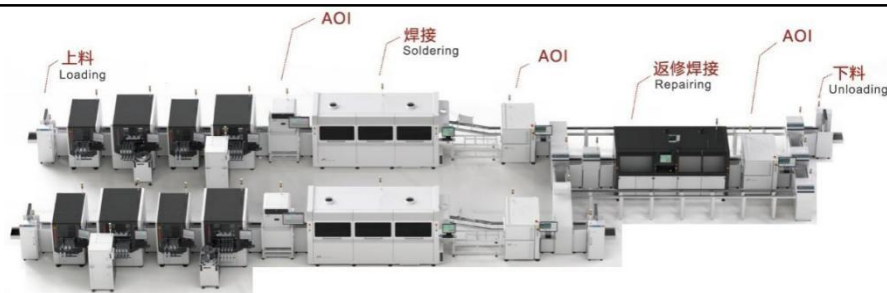
证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	南方财经（潘晓霞、关妙钿、朱清华）、摩根士丹利基金（陆伟成）等，合计约 35 名机构和个人投资者。
时间	2026 年 9 月 22 日（星期二）9:00 至 11:00
地点	劲拓光电产业园（深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号）
上市公司接待人员姓名	董事长 吴思远（Wu Siyuan）先生 董事会秘书 胡毅先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书介绍公司基本情况 （一）公司简介 公司成立于 1997 年，2014 年在深交所创业板上市（股票代码 300400），是一家集研发、生产、销售和服务于一体的电子热工装备制造龙头企业，产品广泛应用于消费电子、通讯电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子、机器人电子元件等领域的精密制造。 （二）公司从事的主要业务       图：公司电子制造专用设备的部分应用领域 公司电子装联设备覆盖电子 PCBA 生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设备+AOI 和 SPI 检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统；作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊设备全球市场份额居前、系国家制造业单项冠军产品。上市 12 年以来，公司持续盈利，技术驱动是穿越周期的核心，公司近年来持续加大研发投入，形成对底层技术的深刻理解，构建公司独特的竞争力。



图：零缺陷焊接检测制造系统示意图

（三）公司的经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 78,513.89 万元，较上年同期增长 7.74%；其中：电子装联设备业务实现营业收入 72,696.19 万元，占营业总收入的 92.59%，较上年同期增长 13.97%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,397.85 万元，较上年同期增长 0.97%；经营性现金净流入 25,629.92 万元，较上年同期增长 108.99%。

2026 年半年度，公司实现营业总收入 41,798.21 万元，较上年同期增长 13.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,744.84 万元，较上年同期增长 7.68%；经营性现金净流入 3,838.13 万元，较上年同期下降 51.60%。

公司 2025 年度及 2026 年半年度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》和《2026 年半年度报告》。

二、问答交流

1、请介绍公司在电子热工设备行业中的竞争优势？

回复：公司专注于电子热工行业近 30 年，持续的投入和积累，劲拓股份拥有全行业最完善的产品图谱，累计服务了全球 150+个地区的近 7000 家客户；同时公司凭借良好的供应链管控和售后服务体系，在行业获得了良好的市场口碑和品牌形象；公司已多年牢牢占据电子热工装备行业的龙头地位；公司主力产品回流焊设备，连续 2 次获得国家工信部颁发的“制造业单项冠军产品”荣誉。在行业深耕多年的基础上，公司自 2023 年积极拥抱 AI 时代带来的全新机遇，以“技术导向”为核心发展战略，率先于行业开展前沿技术攻关；公司聚焦电子热工设备 AI 智能化升级，同时与客户联合攻关服务于大尺寸 AI 服务器芯片 PCBA 焊接的热工设备，在解决行业需求痛点的关键性能指标上表现突出，获得全球顶级客户认可。在与客户联合开展前沿技术攻关的过程中，劲拓将多年合作从传统的买卖对接深化为紧密的研发创新共同体，深度参与客户项目开发，共建工艺标准。这种双向赋能不仅让公司持续保持对产业技术前沿的敏感度，也助力其稳步迈向“行业前沿技术新工艺新标准制定者”的目标，持续引领高端制造的智能化升级。

投资者关系活动 主要内容介绍	2、公司未来业务发展的重点方向是什么？ 回复：公司将继续聚焦热工装备的核心主业，加大研发投入，推进产品智能化、高端化升级；另外，公司也正在加大海外市场开拓，持续构建海外市场服务能力。 3、公司大尺寸芯片焊接设备解决什么样的问题，下游可以应用的场景有哪些？ 回复：产业中没有一个统一标准定义“大尺寸”芯片的具体尺寸，但从板级封装（PCBA）的行业经验看，自从芯片模组的尺寸超过 50mm*50mm 之后，采用产业传统的回流焊焊接工艺，PCB 翘曲问题（warpage）已显著的成为了行业痛点。算力芯片及交换机芯片等在先进封装工艺升级过程中，芯片模组已呈现出尺寸越来越大的产业趋势，所以改善热工焊接翘曲问题，就会成为 PCBA 环节非常关键的技术创新课题。从场景看，公司当前面对的大尺寸芯片应用的行业需求，主要集中于 AI 服务器中的多类芯片，如 GPU、CPU、ASIC 专用算力芯片、交换机芯片等。 4、玻璃基板的应用，是否就可以减少对于大尺寸芯片焊接设备的使用需求？ 回复：目前业界尝试用不同的技术路线来改善芯片模组板级焊接时出现的翘曲问题，包括新材料的应用、新生产工艺的应用等等。业界讨论的玻璃基板方案，也是因为 AI 芯片模组尺寸持续增加，为解决先进封装环节的基板翘曲而开发的新材料体系。公司开发的超大尺寸集成电路专用回流焊设备，是从新生产工艺的角度应对 AI 芯片模组 PCBA 环节的翘曲问题，所以与玻璃基板，及其他新材料应用方案，不是相互替代关系，是共同配合的关系。另外，玻璃基板的产业化推广过程，对于 PCBA 热工焊接环节也提出新的温控需求，公司也已经就玻璃基板等新材料方案，开展了设备新工艺的预研工作。 5、公司智能化热工生产设备，具体在解决什么问题？ 回复：热工生产设备以电能加热，部分高可靠性场景还会充氮以降低工作区氧含量，因此节能节氮是客户降本的关键。在实际生产中，同一设备常需适配多种 PCBA 产品，换产线时需经验丰富的工程师重新调试设备工作参数，该过程会产生物料和工时损耗。另外随着客户产能向海外扩张，提升设备复杂工况的适应能力，和远程保障支持能力，成为客户越来越强烈的需求。公司推出的智能化电子热工装备，致力于通过分级实现智能化功能，在节能节氮、降低人工依赖、减少物料和工时损耗等方面为客户带来直接经济价值，并改善综合使用体验。 6、公司产品使用寿命怎么样？ 回复：正常来说，设备都可以按照 5—10 年折旧来作为使用期限。但因为 SMT 环节多、细分领域技术变化快，所以下游客户会根据实际技术需求做设备的更新调整，我们也会
---------------------------	--

投资者关系活动主要内容介绍	配合客户做新产品开发。如果下游技术快速迭代，也会倒逼生产设备的性能快速升级和存量替换。 7、公司设备交付周期多长？ 回复：根据我们合同订单规模结合客户交付需求，如果是复杂的定制化设备，从采购、生产到交付需要 2-3 个月时间。标准配置设备，大约 35-45 天可以完成交付。 8、公司马来西亚工厂是怎样的计划？ 回复：公司马来西亚子公司主要产品为电子热工装备，包括标准设备和定制设备，定位是服务中国大陆以外其他区域市场的需求。公司在生产制造、售后支持等方面持续扩大海外团队建设，并就海外售后体系已启动与客户的联合培养项目，目标为海外客户提供全方位高质量服务。 9、2026 上半年营收同比增长，但经营活动现金流净额同比大幅下降，什么原因？公司如何管控回款。 回复：主要有两个因素，一是历史基数原因：2023 年之后公司收缩光电板块的业务规模，加大了对前期光电板块应收款的催款力度，近几年特别是 2025 年，实现了现金回款规模好于当年净利润的情况，但到了 2026 年，该部分贡献的影响基本已经不显著。二是业务发展的原因：部分芯片及电子元件涨价，2026 年消费电子行业对公司设备采购需求同比下滑，公司积极开拓新市场，如 AI 算力、新能源、工业电源等领域，订单规模实现同比增长，但其采购生产交付和回款节奏，与原有产品结构相对来说发生变化。但总体来说，目前公司经营现金流情况保持在健康状态。 10、公司所在行业下游需求周期变化，但上市 12 年，未出现过单年度的亏损，而且持续探索业务新方向，并通过分红和回购给了股东不错的回报，请讲讲公司的总体经营策略。 回复：劲拓公司上市 12 年以来，只通过 IPO 的方式向资本市场募资 1.5 亿元左右，但累计分红回购回馈股东近 6 亿元，同时也是所在区域的纳税大户。过往公司总体的经营策略非常稳健，通过自有资金滚动的方式，购置多处自持物业，建立扎实有效的研发生产服务体系，呈现出健康的财务状况，并成为了电子热工细分领域多年的龙头企业。但公司的经营策略并不保守，公司一直在挖掘新市场的机会，过去已开展过数次新的业务探索，当 AI 时代来临，过去 3 年又通过高强度的研发投入形成了公司全新的热工装备核心技术和产品竞争力。至始至终，致力于成为一家重视技术创新积极拥抱产业变化，稳健经营持续提升内在价值，积极回报社会、回馈股东的企业。
----------------------	---

	三、现场参观 调研人员有序参观了公司研发实验室和部分生产车间，了解公司在电子热工设备、AOI 设备和 SPI 检测设备及周边自动化设备的生产成果。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 22 日